公司代码:603061　　公司简称:金海通

# 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、现金分红:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元(含税)。截至 2026 年 3 月 10 日公司总股本 60,000,000 股,公司拟合计派发的现金分红总金额为 22,800,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 12.92%。

2、资本公积转增股本:公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2026 年 3 月 10 日,公司总股本为 60,000,000 股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为 87,000,000 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积—一股本溢价"科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整现金分红、转增股份总额,具体调整情况将另行公告,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金海通 | 603061 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘海龙 | 蔡亚茹 |
| 联系地址 | 上海市青浦区嘉松中路 2188 号 | 上海市青浦区嘉松中路 2188 号 |
| 电话 | 021-52277906 | 021-52277906 |
| 传真 | 022-89129719 | 022-89129719 |
| 电子信箱 | jhtdesign@jht-design.com | jhtdesign@jht-design.com |

2、报告期公司主要业务简介

(1)所属行业

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备,根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020 — 2024),隶属于专用设备制造业(行业代码:C35);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)细分子行业。

(2)集成电路行业发展情况

①集成电路行业简介

半导体本质是一种导电性可受控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角,半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等,发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用与系统实施的全体系的产业;从环节视角,半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系;从功能视角,半导体包括集成电路和分立器件。集成电路是半导体产业的核心,也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础,也是改造和提升传统产业的核心技术,按其功能、结构的不同,集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试等。

公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机,主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备,分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆的测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节,主要使用的测试设备为测试机和探针台,而在芯片设计验证、成品测试环节,主要使用的测试设备为测试机和分选机。

②集成电路专用设备行业简介

专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑,是完成晶圆制造和封装测试环节的基础,是实现集成电路技术进步的关键,在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大,价值量较高。专用设备主要包含前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积(CVD)设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等;后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等;测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备,在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术,具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

③行业发展情况

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征,这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下,2025 年全球半导体行业延续增长态势,先进封装、AI 及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会(SIA)数据显示,2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元,较 2024 年同比增长 25.6%,创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。上述驱动因素动能的持续释放,将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。

特别是随着先进封装、AI 算力芯片等的发展,相关芯片测试的复杂度在攀升,芯片测试总耗时大幅提高,对高端测试资源的需求在快速增加;与此同时,相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面,对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。

未来,集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工,为确保产品质量、生产效率和生产稳定性,半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合,提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发,产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时,测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求,测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。

(3)公司主营业务情况

自成立以来,公司一直专注于全球半导体芯片测试设备领域,同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售,客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度,产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

公司产品集成电路测试分选机在客户公司(半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业、芯片设计公司等)所分选的芯片涵盖汽车电子、消费电子、智能互联、5G、人工智能等领域中应用的芯片(公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为)。

(4)公司主要产品介绍

公司深耕平移式测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列等不同系列的测试分选机。

公司产品测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成,可以精准模拟芯片真实使用环境,并实现多工位并行测试,其 UPH 可达 20,000 颗,Jam rate 低于 1/200,000,可测试芯片尺寸范围可涵盖 2*2mm 至 125*170mm,可模拟最低 -55℃、最高 200℃等各种极端温度环境。

(5)公司主要经营模式

①盈利模式

公司为客户提供集成电路测试分选专用设备及备品备件并获取收入和利润。报告期内,公司主营业务收入主要来源于 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、其他系列等各类型测试分选机产品及相关配件的销售。

②采购模式

公司采购采取询价方式,综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多方面因素选择供应商。公司综合客户订单情况、行业趋势等因素,按照"以销定产"和"安全库存"的形式确定生产计划以及物料需求计划。公司根据每年的供应商交货良率进行评估,结合采购需求及供应商的产品质量和交货能力,与供应商协商询价比选,确定各供应商的采购数量和采购价格等,最终确定采购订单并执行采购。报告期内公司主要供应商保持相对稳定。

③生产模式

公司产品具有较强的定制化属性,公司主要实行"以销定产"和"安全库存"的生产模式,结合库存和市场情况安排生产计划,并采用核心产品自主生产、部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工。

④销售模式

公司主要的销售模式有直销模式和代理模式,客户群体主要分布在中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体研发、加工产业发达的国家和地区,其中,境内销售以直销模式为主,境外销售主要有直销和代理模式。对于直销模式与代理模式,主要由公司与终端客户直接签署销售合同。代理模式下,待客户验收设备并支付货款后,公司根据代理协议支付代理商相应佣金。公司具有完善的售后服务体系,公司在境内外设立了子公司或售后团队负责当地及周边客户的售后工作。

⑤研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及算法类、工艺类等多个方向,研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组分别进行。公司对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了相应规定。研发项目完成立项、审批程序后,形成技术方案;不同研发小组根据技术方案分别进行新产品相关模块的设计,并根据设计完成新产品制造,通过阶段性测试与综合测试之后,进行试生产验证。在实际生产环境测试中,研发小组成员会根据反馈持续完善产品性能,直至新产品正式定型,并投入量产。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,149,652,155.84 | 1,598,565,608.03 | 34.47 | 1,584,983,205.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,614,293,008.86 | 1,316,232,759.41 | 22.64 | 1,398,855,603.87 |
| 营业收入 | 698,176,005.39 | 406,666,316.61 | 71.68 | 347,234,545.48 |
| 利润总额 | 196,800,497.09 | 84,850,967.53 | 131.94 | 92,726,544.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,525,276.68 | 78,481,491.79 | 124.93 | 84,794,096.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 171,048,596.02 | 67,736,509.73 | 152.52 | 69,465,975.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,809,505.47 | 58,986,103.16 | 116.68 | -48,361,309.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.22 | 6.01 | 增加 6.21 个百分点 | 6.84 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.05 | 1.35 | 125.93 | 1.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.04 | 1.35 | 125.19 | 1.47 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 128,605,637.35 | 178,810,367.32 | 174,179,734.83 | 216,580,265.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,658,510.03 | 50,347,028.65 | 48,975,719.98 | 51,544,018.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,309,116.01 | 49,504,980.56 | 47,665,465.08 | 49,569,034.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,983,247.41 | 10,593,454.00 | 33,374,315.90 | 77,858,488.16 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

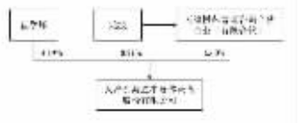
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 8,806 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,208 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 崔学峰 | 0 | 8,511,132 | 14.19 | 8,511,132 | 质押 | 2,550,000 | 境内自然人 |
| 宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,369,685 | 8.95 | 0 | 质押 | 1,680,000 | 其他 |
| 龙波 | 0 | 5,344,146 | 8.91 | 5,344,146 | 质押 | 530,000 | 境内自然人 |
| 南通华泓投资有限公司 | 0 | 3,958,890 | 6.60 | 3,958,890 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -916,000 | 3,042,471 | 5.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 钟格 | 590,000 | 2,870,000 | 4.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天津金海通半导体设备股份有限公司-2025 年员工持股计划 | 1,734,770 | 1,734,770 | 2.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | -677,400 | 1,719,953 | 2.87 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 秦维辉 | 72,200 | 955,842 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 727,781 | 734,581 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人,崔学峰与龙波为一致行动人;<br>2、上海瀚岚动投资有限公司作为有限合伙人持有上海金浦、南京金浦的财产份额,上海金浦、南京金浦还拥有共同的合伙人上海岚焜企业管理中心(有限合伙)、上海金浦新朋私募基金管理有限公司、上海瀚岚动投资有限公司;<br>3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

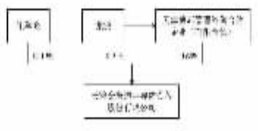
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2026-023

# 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例、每股转增比例:向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.50 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整现金分红、转增股份总额,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司所处的半导体专用设备制造领域,对于持续研发的需求较高,资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 176,525,276.68 元,其中母公司实现净利润 190,126,272.31 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提取法定盈余公积金后截至 2025 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 621,360,576.53 元,资本公积余额为 913,289,420.01 元。经董事会决议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、现金分红:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元(含税)。截至 2026 年 3 月 9 日公司总股本 60,000,000 股,公司拟合计派发的现金分红总金额为 22,800,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 12.92%。

2、资本公积转增股本:公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.50 股。截至 2026 年 3 月 9 日,公司总股本为 60,000,000 股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为 87,000,000 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积—一股本溢价"科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整现金分红、转增股份总额,具体调整情况将另行公告,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及其他风险警示的情形。

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 22,800,000.00 | 9,906,089.10 | 10,191,171.38 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 176,525,276.68 | 78,481,491.79 | 84,794,096.91 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 621,360,576.53 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 42,896,260.48 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 113,266,955.13 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 42,896,260.48 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元 | 是 | | |
| 现金分红比例(%) | 37.87 | | |
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2025 年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 176,525,276.68 元,公司拟分配的现金红利总额为 22,800,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业,对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力,集成电路测试设备需要进行持续的研发,从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段,需要投入较高人力成本及研发费用等经常性开支,资金需求量较大。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司处于成长阶段,公司将继续专注服务半导体封装测试行业,根据国家政策和战略发展需求,不断加强自主技术创新能力,努力拓宽客户群体和市场,积极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作,时刻把握市场动态,围绕自身技术优势,结合行业发展趋势,持续进行研发创新和技术升级。

(三)公司盈利水平及资金需求

2025 年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 176,525,276.68 元。公司业务仍在持续发展,为保障公司业务发展,公司有较高的资金需求。

(四)公司现金红利水平较低的原因

公司坚持稳健的利润分配政策,在制定每年的分红政策时,会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排,兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素,有利于公司长期稳健发展,不会损害投资者利益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有,将用于加强自主技术创新能力,努力拓宽客户群体和市场等,确保公司长期稳健发展,为股东创造长期稳定的回报。

(六)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持提升软、硬件研发能力,完善研发体系,提高团队专业化程度,提升生产运营效率以及深化公司核心竞争力,积极履行公司的利润分配制度,重视以现金分红形式对投资者进行回报,为全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案并修订《公司章程》的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划,符合公司实际情况。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案并修订《公司章程》的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2026-024

# 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 9 日,天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于增加预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为:本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则,没有损害公司和股东权益的情形,符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为:本次关联交易预计符合公司业务的发展需要,交易价格公允,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将以上议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

2026 年 3 月 10 日,公司第二届董事会第二十六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于增加预计 2026 年度日常关联交易的议案》,关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为:本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况,为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次预计关联交易金额总额未超过本公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二)本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

为满足公司日常经营发展需要,公司拟新增与关联方南通华达微电子集团股份有限公司的日常关联交易事项,交易内容主要为公司向关联方出售半导体测试分选机及相关备品备件,本次预计新增日常关联交易金额合计不超过 2,000 万元,公司 2026 年度日常关联交易预计金额从 17,440 万元上升至 19,440 万元,具体情况如下:

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2026年原预计额度(万元) | 本次拟增加预计额度(万元) | 本次增加后 2026 年预计总额度(万元) | 2026年 1 月实际发生金额(未经审计)(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售商品 | 通富微电子股份有限公司 | 3,000 | | 3,000 | 178.29 |
| 向关联方销售商品 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 1,000 | | 1,000 | 1.85 |
| 向关联方销售商品 | 南通通富微电子有限公司 | 4,000 | | 4,000 | 2.78 |
| 向关联方销售商品 | TF AMD MICROELEC-TRONICS (PENANG) SDN. BHD. | 1,000 | | 1,000 | 198.31 |
| 向关联方销售商品 | 合肥通富微电子有限公司 | 2,000 | | 2,000 | |
| 向关联方销售商品 | 通富通科(南通)微电子有限公司 | 5,000 | | 5,000 | 58.50 |
| 向关联方销售商品 | 南通华达微电子集团股份有限公司 | 0 | 增加 2,000 | 2,000 | |
| 向关联方租赁房产 | 上海新朋实业股份有限公司 | 1,440 | | 1,440 | 85.36 |
| 小计 | | 17,440 | 增加 2,000 | 19,440 | 525.09 |

注 1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述 6 家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注 2:上表中,2026 年 1 月实际发生金额均为含税金额;

注 3:2024 年 12 月,公司第二届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2025 年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司等发生总额不超过 8,100 万元的日常关联交易;同时,公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产,预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440 万元的日常关联交易。

2025 年 12 月,公司第二届董事会第十九次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》,同意将 2025 年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司的关联交易预计总额度从 8,100 万元增加至 9,600 万元(增加预计总额度 1,500 万元),相关日常关联交易预计和执行情况详见下表:

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025年原预计额度(万元) | 2025年内部调剂后的预计额度(万元)注 2 | 前次增加预计额度(万元) | 前次增加后 2025 年预计额度(万元) | 2025年内部调剂后的预计额度(万元)注 3 | 2025年实际发生金额(经审计)(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售商品 | 通富微电子股份有限公司 | 1,000 | 2,700 | 增加 1,000 | 3,700 | 3,700 | 3,213.76 | |
| 向关联方销售商品 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 500 | 100 | | 100 | 100 | 75.61 | |
| 向关联方销售商品 | 南通通富微电子有限公司 | 3,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 684.58 | |
| 向关联方销售商品 | TF AMD MICROELEC-TRONICS (PENANG) SDN. BHD. | 2,100 | 1,200 | | 1,200 | 1,200 | 862.56 | |
| 向关联方销售商品 | 合肥通富微电子有限公司 | 500 | 500 | | 500 | 600 | 559.67 | |
| 向关联方销售商品 | 通富通科(南通)微电子有限公司 | 1,000 | 2,600 | 增加 500 | 3,100 | 3,000 | 2,529.15 | |
| 向关联方租赁房产 | 上海新朋实业股份有限公司 | 1,440 | 1,440 | | 1,440 | 1,440 | 1,045.61 | |
| 小计 | | 9,540 | 9,540 | 增加 1,500 | 11,040 | 11,040 | 8,970.94 | |

注 1:上述关联交易在关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂,苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司,前述 6 家公司为同一控制下的不同关联方,关联交易金额可以内部调剂;

注 2:本列为公司根据 2025 年 1-10 月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额;

注 3:本列为公司根据 2025 年 1-12 月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要,在关联交易预计总额范围内,对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额;

注 4:上表中,2025 年实际发生金额均为含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

1、南通华达微电子集团股份有限公司

(1)关联人的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 南通华达微电子集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320600138298807R |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 石明达 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 成立日期 | 1990 年 10 月 11 日 |
| 住所及主要办公地点 | 南通市紫琅路 99 号 |
| 主营业务 | 生产销售半导体分立器件、集成电路电子应用产品;经营本企业自产产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);矿产品销售;自有房屋租赁、停车场服务(另设分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

关联人最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2025年 12 月 31 日(未经审计) | 2026年 1 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 3,999,513,885.12 | 4,930,440,989.03 |
| 净资产 | 3,650,192,048.42 | 4,194,343,472.08 |
| 项目 | 2025年度(未经审计) | 2026年 1 月 31 日(未经审计) |
| 营业收入 | 299,597,659.2 | 31,424,557.73 |
| 净利润 | 96,922,695.86 | 544,161,573.56 |

(2)与公司的关联关系

南通华达微电子集团股份有限公司为公司 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,南通华达微电子集团股份有限公司为公司关联方。

(3)履约能力分析:南通华达微电子集团股份有限公司为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司主要为南通华达微电子集团股份有限公司供应半导体测试分选机及相关备品备件,产品价格遵循市场化原则,由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则。本次增加预计 2026 年度日常关联交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形,公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事、审计委员会已召开专门会议审议本次关联交易事项,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2026-022

# 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2026 年 3 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》,同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下:

一、信用减值及资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计 29,553,770.27 元,具体情况如下:

单位:元

| 序号 | 项目 | 2025年 1-12 月计提减值准备金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信用减值准备 | 25,841,866.34 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 |
| 2 | 资产减值准备 | 3,711,903.93 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 |
| 合计 | | 29,553,770.